

IMPACT

Interne TE-Nummer 2057760-2

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 72 Position,
Mating Alignment, Guide Pin Mating Alignment Type, 9 Row, 8
Column, IMPACT

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **72**

Reihenabstand: **1.35 mm [.053 in]**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Führungsstift**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Signalanordnung	Differenzial
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Massepositionen	24
Anzahl der Paare	24
Stapelbar	Nein
Anzahl der Signalpositionen	48
Anzahl von Positionen	72
Zeilenanzahl	9
Spaltenanzahl	8
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Führungsposition	Nicht geführt

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	30 VAC
-----------------	--------

Signalmerkmale

Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	3
Datenrate	25 Gb/s

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	4.9 mm[.193 in]
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	1.27 μm [50 μin]
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe
Kontakttyp	Stift
Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts	1.27 μm [50 μin]
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm [29.92 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontakt-nennstrom (max.)	.75 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	1.2 mm[.047 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

Führungskomponenten	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Führungsstift
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Anzahl der gehüllten Seiten	Zweiseitig
Endwandposition	Öffnen
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer,

	Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	1.9 mm[.075 in]

Abmessungen

Steckverbinderlänge	15.1 mm[.594 in]
Steckverbinderhöhe	11.95 mm[.47 in]
Steckverbinderbreite	16.7 mm[.657 in]
	.039 in
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.46 mm[.018 in]
Reihenabstand	1.35 mm[.053 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Dateinummer	E28476
UL-Grad	Anerkannt
CSA zertifiziert	Ja
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Box, Karton & Schlauch, Karton & Schlauch
--------------------	---

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I <

900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | IMPACT



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW46,4.9](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2057760-2_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2057760-2_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2057760-2_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch



Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch